



技術能力 (大ロット _ PCB)

プロセス	項目		量産能力
通常	層数		≤12層
	板厚		0.30-3.2mm
	板厚公差		±10%
	インピーダンス 公差要求	デジタル/特性 ≥50Ω	±10%
		特性≤50Ω	±5ohm
反り		≤0.7%	
積層及び ラミネート	PP厚		≥3.0mil
ドリル	最小機械ドリル径		0.15mm
	穴径公差	PTH	±0.05mm
		NPTH	±0.025mm
メッキ	アスペクト比	スルーホール	12: 1
配線設計	内層スペース	層数: 4-10L	≥6.5mil
		層数: 12-16L	≥7.0mil
	内層 線幅/スペース	(内層1/2OZ)	3/3mil
	最大基材銅箔厚	内層	≤3OZ
		外層	≤2OZ
	外層 線幅/スペース	トータル銅厚 30-40μm	3.5/3.5mil
		トータル銅厚 40-55μm	4/4mil
	線幅公差	線幅≥10mil	±2mil
線幅<10mil		±20%	
パッド公差	パッド≥12mil		≥±10%

プロセス	項目		量産能力
レジスト設計	レジストダム幅		≥3mil
	レジスト穴埋め	穴埋め穴径	0.25-0.60mm
	レジスト厚	導体平面	10-40μm
		コーナー部 (min)	≥5μm
ルータ	ルータ	外形公差	≥±100μm
表面処理	電解金メッキ	金厚	0.127-1.0μm
		ニッケル厚	2.54-6μm
	無電解 ニッケル-金	金厚	0.03-0.10μm
		ニッケル厚	2.54-6.0μm
	OSP	フィルム厚	0.2-0.6μm
	鉛フリー半田レベラー		1-25μm
	無電解銀メッキ		0.15-0.38μm
	無電解錫メッキ		0.8-1.2μm
金端子	金厚		0.127-0.8μm
	長さ公差 (エッチング+抵抗めっきインク 組み合わせ)		±0.15mm
	長さ公差 (レジスト+抵抗めっきインク組 み合わせ)		±0.127mm
	幅公差		±50μm